

## PIANO EDITORIALE / EDITORIAL PLAN 2009

NUMERO (ISSUE)	SPECIALE (COVER STORY)	AGGIORNAMENTI Approfondimenti UPDATE/IN DEPTH	ARTICOLI GENERALI (GENERAL ISSUES)	ELETTRONICA OGGI WEB EDIZIONE ON LINE ITA/INGL (ITALIAN/ENGLISH ON LINE EDITION) www.ilb2b.it/elettronicaoggiweb.asp	FIERE (EXHIBITIONS) ON LINE CALENDAR
<b>385</b> Gennaio January	<input type="checkbox"/> Semiconduttori di potenza (Power semiconductors)	<input type="checkbox"/> MCU (MCUs)	<input type="checkbox"/> IC analogici/mixed signal (Analog Mixed signal ICs) <input type="checkbox"/> Mems/sensori avanzati (MEMS/advanced sensors) <input type="checkbox"/> Strumentazione T&M (T&M Instruments) <input type="checkbox"/> Elettronica biologica (Biological electronics) <input type="checkbox"/> Compatibilità elettromagnetica (EMC)	<input type="checkbox"/> Design ideas <input type="checkbox"/> Hot news <input type="checkbox"/> Web Exclusive - Trend nell'analogica (Digital trends)	
<b>386</b> Febbraio February	<input type="checkbox"/> Soluzioni programmabili (Programmable solutions)	<input type="checkbox"/> Tool EDA (EDA tools)	<input type="checkbox"/> Potenza digitale (Digital power) <input type="checkbox"/> Gestione termica (Thermal management) <input type="checkbox"/> Elettromeccanici/Passivi/Connettori (Passive/electromechanics/Connectors) <input type="checkbox"/> Nanotecnologie (Nanotechnology) <input type="checkbox"/> Optoelettronica (Optoelectronics)	<input type="checkbox"/> Design ideas <input type="checkbox"/> Hot news <input type="checkbox"/> Web Exclusive - R&D in Italia (R&D in Italy)	<b>NI Days</b> , febbraio, Milano <b>Real Time and Embedded Computing Conference</b> , Atlanta (GA-USA) / Huntsville (AL-USA) / Melbourne (FL-USA) <b>ICQNM 2009 - The Third International Conference on Quantum, Nano and Micro Technologies</b> , 1-6/02, Cancun (MEX) <b>MC<sup>4</sup> Motion Control</b> , febbraio, (I)
<b>387</b> Marzo March	<input type="checkbox"/> Evoluzione degli standard wireless (Wireless standards evolution)	<input type="checkbox"/> IC di alimentazione (Power supply ICs)	<input type="checkbox"/> Test RF (RF test) <input type="checkbox"/> IC analogici/mixed signal (Analog/mixed signal ICs) <input type="checkbox"/> IC condizionamento segnali/datapath (Signal management/datapath ICs) <input type="checkbox"/> Logiche programmabili (Programmable logic) <input type="checkbox"/> IC di interfaccia (Interface Ics)	<input type="checkbox"/> Design ideas <input type="checkbox"/> Hot news <input type="checkbox"/> Web Exclusive - R&D in Europa (R&D in Europe)	<b>Real Time and Embedded Computing Conference</b> Marzo, Dallas / Houston (TX-USA) <b>Embedded World</b> , 3-5/03, Norimberga (D) <b>CeBIT</b> , 3-8/03, Hannover (D) <b>Smart Systems Integration</b> , 10-11/03, Bruxelles (B) <b>EMV</b> , 10-12/03, Stoccarda (D) <b>PCIM China</b> , 17-19/03, Shanghai (RPC)
<b>388</b> Aprile April	<input type="checkbox"/> Nuove tecnologie per le batterie (New technology for battery)	<input type="checkbox"/> Tecnologie a larga banda (Broadband technologies)	<input type="checkbox"/> ASIC/ASSP (ASICs/ASSPs) <input type="checkbox"/> Integrità dei segnali (Signal integrity) <input type="checkbox"/> Nanotecnologie (Nanotechnologies) <input type="checkbox"/> Strumentazione T&M (T&M Instruments) <input type="checkbox"/> TV digitale (Digital TV) <input type="checkbox"/> Optoelettronica e fotonica (Optoelectronics & photonics)	<input type="checkbox"/> Design ideas <input type="checkbox"/> Hot news <input type="checkbox"/> Web Exclusive - Sotto i 45 nm (Below 45 nm)	<b>Embedded Systems Conference - Silicon Valley</b> , 14-18/04, San Jose (CA-USA) <b>Display</b> , 15-17/04, Tokyo (J) <b>Hannover Messe</b> , 20-24/04, Hannover (D) <b>DATE</b> , 20-24/04, Nizza (F)
<b>389</b> Maggio May	<input type="checkbox"/> Strumentazione T&M - Directory (T&M Directory)	<input type="checkbox"/> Convertitori c.c./c.c. (c.c./c.c converters)	<input type="checkbox"/> Interconnessioni seriali (Serial interconnections) <input type="checkbox"/> Energie alternative (Alternative energy) <input type="checkbox"/> Nuove tecnologie di memoria (Memory technology) <input type="checkbox"/> Connessioni chip-to-chip (Chis-to-chip interconnects) <input type="checkbox"/> ASIC/ASSP (ASICs/ASSPs)	<input type="checkbox"/> Design ideas <input type="checkbox"/> Hot news <input type="checkbox"/> Web Exclusive - Progettazione eco-compatibile (Environmentally friendly design)	<b>SMT Hybrid Packaging</b> 5-7/05, Norimberga (D) <b>PCIM Europe</b> , 12-14 /05, Norimberga (D) <b>Enermotive</b> , 26-30/05, Fieramilano (Rho-MI) <b>LinvinLuce</b> 26-30/05, Fieramilano (Rho-MI)

<b>390 Giugno June</b>	<input type="checkbox"/> Microprocessori ( <i>Microprocessors</i> )	<input type="checkbox"/> Standard wireless ( <i>Wireless standards</i> )	<input type="checkbox"/> ID a radiofrequenza ( <i>Rfid</i> ) <input type="checkbox"/> Strumentazione T&M ( <i>T&amp;M instrumentation</i> ) <input type="checkbox"/> MEMS e sensori avanzati ( <i>MEMS and advanced sensors</i> ) <input type="checkbox"/> IC alimentazione ( <i>Power supply ICs</i> )	<input type="checkbox"/> Design ideas <input type="checkbox"/> Hot news <input type="checkbox"/> Web Exclusive - Architetture a bassa potenza ( <i>Low power architecture</i> )	<b>VforM-Vision for Manufacturing</b> , giugno, (I) <b>Laser World of Photonics</b> , 15-18/06, Monaco (D) <b>European Automotive Components Expo</b> 16-18/06, Stoccarda (D)
<b>391 Lug/Ago Jul/Aug</b>	<input type="checkbox"/> Nuove tecnologie ( <i>New technologies</i> )	<input type="checkbox"/> Sistemi ATE ( <i>ATE systems</i> )	<input type="checkbox"/> Elettromeccanici/passivi ( <i>Electromechanics</i> ) <input type="checkbox"/> IC di conversione ( <i>Conversion ICs</i> ) <input type="checkbox"/> Elettronica consumer ( <i>Consumer electronics</i> ) <input type="checkbox"/> Software per la progettazione con Fpga ( <i>FPGA development software</i> ) <input type="checkbox"/> Materiali per EMC ( <i>EMC materials</i> )	<input type="checkbox"/> Design ideas <input type="checkbox"/> Hot news <input type="checkbox"/> Web Exclusive - Energie alternative: il ruolo dell'elettronica ( <i>Alternative energies: the role of electronic industry</i> )	<b>NI Week</b> , agosto, Austin (TX-USA)
<b>392 Settembre September</b>	<input type="checkbox"/> IP/SoC ( <i>IPs/SoCs</i> )	<input type="checkbox"/> DSP roadmap ( <i>DSP roadmap</i> )	<input type="checkbox"/> Autenticazione e cifratura ( <i>Authentication &amp; Encryption solutions</i> ) <input type="checkbox"/> IC analogici/Mixed signal ( <i>Analog/Mixed signal ICs</i> ) <input type="checkbox"/> Strumentazione T&M ( <i>T&amp;M instrumentation</i> ) <input type="checkbox"/> Nuovi materiali per l'elettronica ( <i>New materials for electronics</i> ) <input type="checkbox"/> Integrati e componenti audio ( <i>Audio ICs and components</i> )	<input type="checkbox"/> Design ideas <input type="checkbox"/> Hot news <input type="checkbox"/> Web Exclusive - Trend delle logiche programmabili ( <i>Logic programmable trends</i> )	<b>C<sup>2</sup>-Control &amp; Communication</b> , settembre, (I) <b>Embedded System Conference</b> , settembre, Boston (MA-USA) <b>Nanoforum</b> , settembre, Milano (I)
<b>393 Ottobre October</b>	<input type="checkbox"/> Tecnologie di memoria ( <i>Memory technologies</i> )	<input type="checkbox"/> Tecnologie a larga banda ( <i>Broadband technologies</i> )	<input type="checkbox"/> Strumentazione T&M ( <i>T&amp;M instruments</i> ) <input type="checkbox"/> IC analogici/mixed signal ( <i>Analog/mixed signal ICs</i> ) <input type="checkbox"/> Riutilizzo del design ( <i>Design reuse</i> ) <input type="checkbox"/> Standard wireless ( <i>Wireless standards</i> ) <input type="checkbox"/> Nanotecnologie ( <i>Nanotechnologies</i> )	<input type="checkbox"/> Design ideas <input type="checkbox"/> Hot news <input type="checkbox"/> Web Exclusive - Progettazione a basso consumo ( <i>Low power design</i> )	<b>Semicon Europe</b> , 6-8/10, Stoccarda (D) <b>SAME</b> , 7-8/10, Sophia Antipolis (F)
<b>394 Novembre November</b>	<input type="checkbox"/> Strumentazione EDA ( <i>EDA tools</i> )	<input type="checkbox"/> Tecnologie di compressione ( <i>Compression technologies</i> )	<input type="checkbox"/> ASIC/FPGA ( <i>ASICs/FPGAs</i> ) <input type="checkbox"/> Controllo motori ( <i>Motor control</i> ) <input type="checkbox"/> TV digitale ( <i>Digital TV</i> ) <input type="checkbox"/> Semiconduttori discreti ( <i>Discrete semiconductors</i> ) <input type="checkbox"/> Progettazione ESL ( <i>ESL Design</i> )	<input type="checkbox"/> Design ideas <input type="checkbox"/> Hot news <input type="checkbox"/> Web Exclusive - Evoluzione delle tecnologie di memoria ( <i>Memory technology evolution</i> )	<b>Focus Embedded</b> , novembre, (I) <b>Productronica</b> , 10-13/11, Monaco (D) <b>SPS/IPC/Drives</b> , 24-26/11, Norimberga (D)
<b>395 Dicembre December</b>	<input type="checkbox"/> Tecnologie di conversione ( <i>Conversion technologies</i> )	<input type="checkbox"/> Mcu Multicore ( <i>Multicore Mcu</i> )	<input type="checkbox"/> Strategie di collaudo ( <i>Test strategies</i> ) <input type="checkbox"/> Energie alternative ( <i>Alternative energy</i> ) <input type="checkbox"/> Strumentazione T&M ( <i>T&amp;M Instruments</i> ) <input type="checkbox"/> Tecniche di coprocessign ( <i>Co-processing techics</i> ) <input type="checkbox"/> Standard wireless ( <i>Wireless standard</i> )	<input type="checkbox"/> Design ideas <input type="checkbox"/> Hot news <input type="checkbox"/> Web Exclusive - 2009: trend tecnologici nell'industria elettronica ( <i>2009: technology trends in electronic industry</i> )	

**SEGNATE IL VOSTRO INDIRIZZO IN STAMPATELLO / PLEASE WRITE YOUR ADDRESS IN BLOCK LETTERS**

AZIENDA / COMPANY		PERSONA / CONTACT	
VIA/STREET			
CAP / POST CODE		CITTÀ' (PROV) / CITY (DISTRICT)	
TEL.	FAX	EMAIL	<b>Grazie per la collaborazione Thank you for your coheration</b>

In base agli argomenti da Voi selezionati, la Redazione provvederà a contattarVI per tempo, riservandosi il vaglio e la pubblicazione del materiale inviato.

**N.B. Questo piano editoriale potrà subire variazioni**

*The editorial department will contact you soon after reviewing the topics you've selected, reserving the right to screen and publish the material submitted.*